

本商品品名：**RMA-223-UV**

规格：**10CC**

产品尺寸：约 97mm(长) x 约 30mm(最大直径)



适应范围: 广泛使用手机板之SMD返修工艺

特点: 残留物少、焊点亮、烟雾少、无刺激气味

操作方法

OPERATION METHOD

- 1、焊接时，将助焊膏涂在被焊物品上，或直接用锡线粘助焊膏，然后用烙铁加热焊接；
- 2、焊接之后焊锡膏的残留物，需及时用乙醇或异丙醇等其他有机溶剂擦洗。

注意事项

MATTERS NEED ATTENTION

作业时请佩戴口罩或安装抽气扇，以防吸入过多焊接时产生的气体，操作完需洗手；
如接触皮肤请用乙醇或异丙醇擦洗，接触眼睛需到医院就医；
存储及运输：不用时，必须密封产品，保存在要求的环境中，在冰箱密封保存好。